

Technische Merkblatt

Easy Print /Sn96,5Ag3Cu0,5/

Paste zum Lötendon SMD-Teilen für die Produktionsprozesse, die keine Reinigungsphase berücksichtigen. Sie basiert auf dem Flussmittel Typ No Clean, braucht nicht gereinigt werden. Die Reste bilden keine Korrosionsquellen. Das Produkt ist gut verwendbar für alle bleifreien Legierungen, zeichnet sich mit guter Haft- und Benetzungsfähigkeit von gelöteten Flächen aus. Die Paste verliert ihre physischen und chemischen Eigenschaften nicht mal nach 20 Stunden Wirkung auf einer PCB-Platte. Die Zeit ist von den im Raum herrschenden Bedingungen wie Feuchtigkeit und Temperatur abhängig.

Verwendung:

- Elektronik,
- Elektrotechnikautomatisches Lötten,
- manuelles LötensMD-Montage
- bei automatischen Druckverfahren
- bei Hand-Druckverfahren

Physikochemischen Eigenschaften:

Eigenschaften	Wert	Standards
chemische		
Art. des Bindemittels	Sn96,5Ag3Cu0,5	
Flussmittelklassifizierung	REL - 0	J-STD - 004
Papierchromatographietest an C.I.	erfüllt (REL - 0)	IPC TM 650
physikalische		
Dichte	≈ 4,6 g/cm ³	IPC-TM 650T
Körnung	25-45 μm	IPC-TM 650T
Viskosität	1,0 G/mm ² po 24h	IPC J-STD - 005
Eignung zum Drucken	über 8h	
elektrische		
SIR-IPC	> 2,6*10 ⁹ Ω, Messung nach 7 Tagen	IPC J-STD 004 (85°C, w 85%)

Symbol:

SIR - Surface Insulation Resistance -Oberflächenwiderstand des Widerstands

Amerikanische Standards, die technische Anforderungen an Pasten und Flussmittel definieren

Anwendungsanforderungen:

Lagerung	Drucken	Lutowanie rozplywowe	Waschen
<ul style="list-style-type: none"> Lagern bei einer Temperatur von 3-7 °C für einen Zeitraum von höchstens 6 Monaten in dicht verschlossenen Behältern die beste (optimale) Temperatur zum Auftragen der Paste: 23-26 °C max. Temperatur zum Auftragen der Paste 28 °C um Änderungen der Schmiereigenschaften der Paste zu vermeiden, verbinden Sie die benutzte Paste nicht mit frischer Paste, um Feuchtigkeitskondensation zu verhindern und die entsprechenden Eigenschaften der Paste zu erhalten, vor dem Öffnen einige Stunden Umgebungstemperatur annehmen lassen 	<ul style="list-style-type: none"> lasergeschnittene oder elektroformte Schablonen: 100 µm für Raster = 0,4 mm 150 µm für Raster => 0,5 mm Metallraket empfohlen Rakelgeschwindigkeit im Drucker: 25-150 mm/s Druck auf die Rakel: 1,5-3 N pro cm Länge Pastenmenge auf der Schablone: 15-20 mm dicke Walze, die vor der Rakel rollt 	<ul style="list-style-type: none"> alle Lötmethoden sind möglich (in normaler Atmosphäre und in Stickstoff) Vorheizen konstanter Anstieg von 1-2,0 °C/s auf Temperatur in Höhe von 145-160 °C oder max. 210-220 °C für die Version ohne Plateau Plateau-Phase (nur für Packungen mit hoher Dichte an Elementen unterschiedlicher Masse) 145-160 °C für 60-90 s Löten - Reflow-Phase: 30-90s über 180 °C Kühlung: Gradient: 1-2 °C/s 	<ul style="list-style-type: none"> Paste als „no clean“ erfordert grundsätzlich kein Waschen wenn Waschen notwendig ist, empfehlen wir PCB Alkoholreiniger

Verpackung:

Kapazität	Art. der Verpackung	Sammelverpackung	Artikelcode
1,4 ml	Spritze	5	ART.AGT-028
20 g	Kartusche	1	ART.AGT-029
40 g	Kartusche	1	ART.AGT-030
250 g	Kunststoffbox	1	ART.AGT-026
500 g	Kunststoffbox	1	ART.AGT-032